

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17667-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 26.02.2020

Ausstellungsdatum: 26.02.2020

Urkundeninhaber:

**Deutscher Sparkassen Verlag GmbH
EMVCo- und DK-Prüflabor,
Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart**

Prüfungen in den Bereichen:

**Funktionsprüfungen von Chipkarten mit Betriebssystem SECCOS im Prüfgebiet Informationstechnik
mit Unterkategorie Smart Cards**

Prüfziele:

Das Prüflabor bietet Prüfungen zur Erlangung einer

- a. DK Modulzulassung**
- b. EMVCo Card Type Approval**

**Innerhalb der angegebenen Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen
Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Modifizierung sowie Weiter- und
Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.**

**Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle
Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.**

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17667-01-00

Beschreibung der Prüfziele

a. Im Rahmen der im DK Zulassungsverfahren sog. „Funktionstests“ wird durch das Berichten des Prüfungsvorgangs „DK Testsuite 1“ eine „DK Modulzulassung“ erlangt und von der DK Zulassungsstelle erteilt.

Prüfverfahren zum Prüfungsvorgang „DK Testsuite 1“:

Titel des Prüfverfahrens	Version des Prüfverfahrens	Beschreibung des Prüfverfahrens	Anforderungen an den Prüfgegenstand
DK Testsuite 1 - Funktionale Tests	1.2	Kontaktbehaftete Tests von Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt.
DK Testsuite 1 - T=1 Tests	1.0	Test der bidirektionalen kontaktbehafteten Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=1 gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt.
DK Testsuite 1 - Recovery Tests	1.0	Test eines konsistenten Datenzustands bei einem kontaktbehafteten Kommunikationsabbruch mit dem Terminal gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt.
DK Testsuite 1 - Funktionale CL-Tests	1.2	Kontaktlose Tests von Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt und unterstützt zusätzlich die kontaktlose Schnittstelle.
DK Testsuite 1 - T=CL Tests	1.1	Test der bidirektionalen kontaktlosen Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=CL gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt und unterstützt zusätzlich die kontaktlose Schnittstelle.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17667-01-00

Titel des Prüfverfahrens	Version des Prüfverfahrens	Beschreibung des Prüfverfahrens	Anforderungen an den Prüfgegenstand
DK Testsuite 1 - Recovery CL- Tests	1.0	Test eines konsistenten Datenzustands bei einem kontaktlosen Kommunikationsabbruch mit dem Terminal gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt und unterstützt zusätzlich die kontaktlose Schnittstelle.

b. Im Rahmen der im EMVCo Zulassungsverfahren sog. „*Card Functional Evaluation*“ wird durch das Berichten der Prüfvorgänge „*EMVCo Level 1 electrical and Protocol Testing*“ und „*EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing*“ eine „*EMVCo Card Type Approval*“ erlangt und von der EMVCo Zulassungsstelle erteilt.

Prüfverfahren zum Prüfvorgang „EMVCo Level 1 electrical and Protocol Testing“:

Titel des Prüfverfahrens	Version des Prüfverfahrens	Beschreibung des Prüfverfahrens	Anforderungen an den Prüfgegenstand
EMVCo Level 1 - electrical Testing	1.1	Kontaktbehaftete Tests der elektrischen Eigenschaften bei 0°C und 50°C gemäß EMV Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Spezifikation Bulletins umgesetzt.
EMVCo Level 1 - Protocol Testing	1.2	Test der bidirektionalen kontaktbehafteten Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=1 gemäß EMV Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Spezifikation Bulletins umgesetzt.

Prüfverfahren zum Prüfvorgang „EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing“:

Titel des Prüfverfahrens	Version des Prüfverfahrens	Beschreibung des Prüfverfahrens	Anforderungen an den Prüfgegenstand
EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing	1.3	Kontaktbehaftete Tests von Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests gemäß EMV Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Spezifikation Bulletins umgesetzt.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17667-01-00

Verwendete Abkürzungen

CCD	Common Core Definition
CPA	Common Payment Application
DK	Die Deutsche Kreditwirtschaft
EMV	Eine Spezifikation für Zahlungskarten der drei namensgebenden Gesellschaften Europay (jetzt MasterCard Europe), MasterCard und Visa.
SECCOS	Secure Chip Card Operating System

Definitionen

DK	Die Deutsche Kreditwirtschaft vertritt die Interessen der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände in Deutschland, siehe www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de .
EMVCo	EMVCo ist eine Evaluierungseinrichtung, welche von diversen internationalen Payment Systems gegründet wurde und gemeinsam betrieben wird, siehe www.emvco.com .